

PALOMAR 6500全自动粘片机

产品名称	PALOMAR 6500全自动粘片机
公司名称	北京锐峰先科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PALOMAR 型号:PALOMAR 6500
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

palomar 6500全自动粘片机

高精度元件粘贴/芯片粘贴系统

6500粘片机是设计用于高速、全自动精密元件组装的系统，并提供了微米级别的定位精度，用于光电子学、无线和医学应用。这一共晶芯片粘片机是设计用于1.5微米定位精度（根据应用不同）的全自动精密元件组装，使得元件组装更实际并且成本更低。

6500全自动粘片机具有一个用于晶圆级别封装共晶粘片的特殊可选配置。

元器件贴装应用

AuSi共晶摩擦

AuSn共晶焊接粘贴

PbSn焊接执行

高精度光学元放置

使用银浆的高精度元件粘贴

P-side向下的激光粘贴

晶圆级别封装 (WSP)

在6500粘片机上的晶圆级别封装(WSP)的共晶粘片给客户提供了一个微电子技术的解决方案，用于P-side向下的激光二极管粘贴(die-to-wafer)。脉冲加热吸头用于80/20 Au/Sn脉冲回流粘贴，晶圆平台有稳态加热，配备用于二极管应用的华夫或凝胶盘。

用于共晶晶圆级别封装的6500粘片机是设计用于全自动、高速度、高精度的P-Side 向下的芯片-晶圆的共晶组装。

高精度图像识别

先进的Cognex图像识别系统使用了向下的摄像头来定位晶圆基板和激光N-side的位置，并能够启用多个对正算法，包括面积、点和边界对正。这一系统包括可编辑开和关的轴照明系统并可自动聚焦，以使对比度和元件定位精度提高。

基于微软视窗系统的操作环境，晶圆级别封装的共晶6500粘片机带来了良好的软件柔性和能力，以及易使用的混合元件组装。用户友好的界面可以帮助焊接设置、操作、诊断和校准。

工艺后的精度可达3微米、对于前激光边缘和条纹位置可达3 sigma

集成摄像头带有激光条纹和激光边界对正算法

高准确度的共晶循环次数少于35秒，包括对每一个激光二极管的即时加热和冷却。

优化的单脉冲加热工具用于特殊的芯片尺寸和所需要的工艺加热曲线，例如 P-side向下的激光粘贴

Palomar科技最近一代的产品集成了脉冲加热曲线控制器，可以对曲线进行编辑和对执行进行追踪

自动的晶圆和激光二极管抓取（可选项）

性能和规格

运动系统: XY 平台： 粘贴区：12 英寸x 6 英寸 (304.8mm x 152.4mm)； 解析度：0.1 微米；

控制系统：空气轴承，线性马达/编码器，直接驱动

Z轴:行程：1.0 英寸 (25.4mm)； 解析度：0.2 微米；

控制系统：音圈，线性编码器，直接驱动

拾取工具：高达6个灵巧的“动态”双向工具塔台

旋转轴：旋转：0-400 度； 解析度：0.000225度，放置工艺后<0.1 度；直接驱动马达

图像识别

视觉系统：256 灰度等级 Cognex 8000系列

PR 旋转角度：取决于应用

聚焦范围：可编辑的聚焦范围0.400”（镜头随Z轴浮动）

物镜：2个可选择的向下观察镜头，1个固定的向上观察相机

可编辑灯光：LED 环形灯并穿过镜头，可分别编辑向下观察和向上观察相机

拾取工具: 支持多种类型的拾取工具：1. 共晶摩擦工具；2. 塑料吸嘴；3. 表明拾取工具；4. 环氧树脂涂抹或标记工具

人体工程学:1. 符合人体工程学设计的用户界面；2. 从机器前通道进入进行工艺控制

硬件和厂务需求

电源: 200、208、220或240 VAC +/- 5%，50 或60 Hz，单相，30 AMP，瞬态自由条件电源

设备压缩空气接口: 150 PSIG + 20, -5 PSIG (对于厂务供应小于150psi的有一个可选的气压放大器) ;空气轴承最小需求为7 SCFM ; 露点抑制 ; 并且灰尘直径 $<5\ \mu\text{m}$, 无油

真空、操作系统:25 in. Hg ; Windows XP

尺寸高度：70 英寸 (1.778 米) ; 占地面积: 36英寸宽 x 35.9英寸深 (0.9144 x 0.91186 米)

重量：2000 磅 (907.19 kg)